

2027年2月期(第42期) 第1四半期 決算説明資料

2026年7月9日

ローツェ株式会社

証券コード：6323

<https://www.rorze.com/ir>

◆ 将来見通しに関する記述について

本資料に記載されている業績予想、将来予測などは、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、その情報の正確性、完全性を保証したり、約束したりするものではありません。また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度等の変化により大きく見通しの変動する可能性があり、今後予告なく変更されることがあります。

◆ 本資料における表示方法について

数 値： 単位未満を切り捨て

比 率： 1円単位の金額で計算後、単位未満四捨五入

会計年度： 年度開始日の暦年表記（「2027年2月期」を「FY2026」または「FY'26」と表記）

会計期間： 連結・当社、国内および海外子会社の会計期間は次のとおり

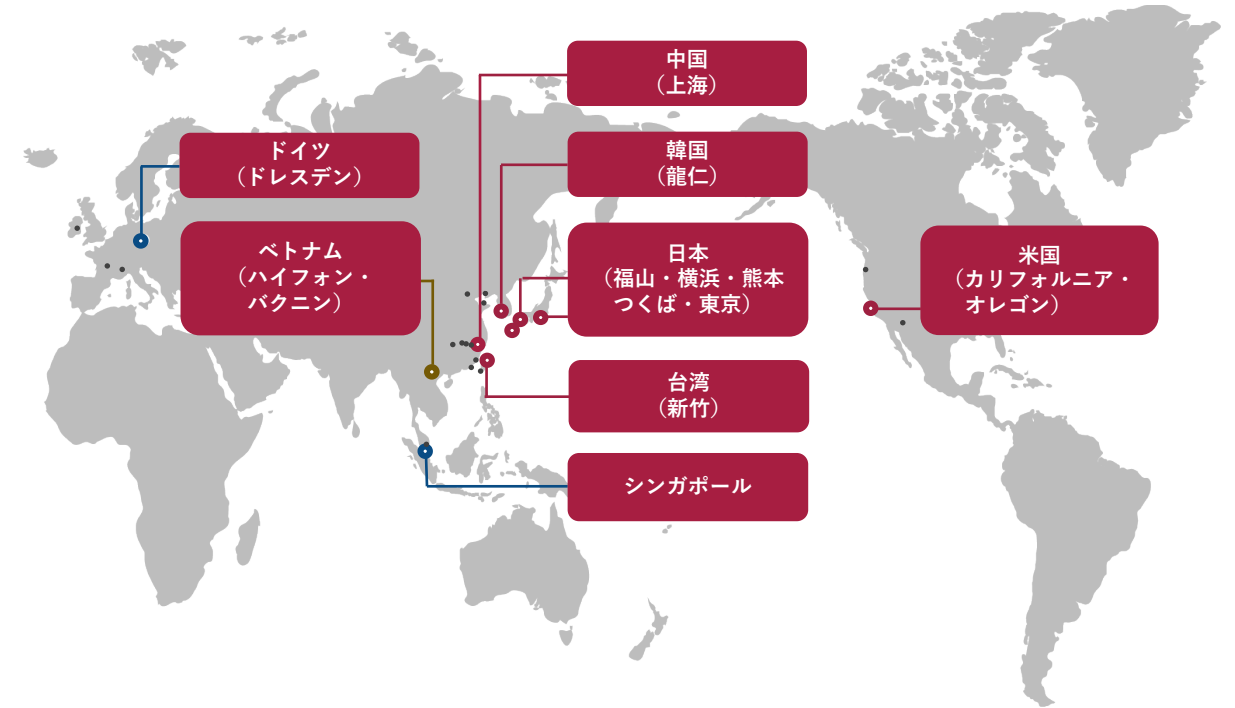
	Q1 (第1四半期)	Q2 (第2四半期)	Q3 (第3四半期)	Q4 (第4四半期)	通 期
連結・当社・国内子会社	3月～5月	6月～8月	9月～11月	12月～翌年2月	3月～翌年2月
海外子会社	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～12月

会社概要



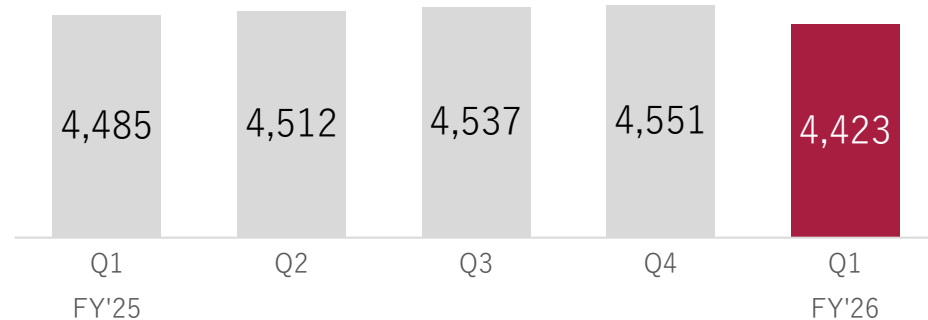
会社名	ローツェ株式会社（英文名；RORZE CORPORATION）
上場市場	東京証券取引所 プライム市場（証券コード：6323）
所在地	広島県福山市神辺町
設立	1985年3月30日
資本金	982百万円
事業内容	半導体・フラットパネルディスプレイ（FPD）・ライフサイエンス関連の自動化・搬送装置の開発・製造・販売
従業員数 ※	連結：4,423名 当社：374名（2026年5月末現在）
事業拠点	国内：福山・横浜・熊本・つくば・東京 海外：米国・ベトナム・台湾・韓国・シンガポール・中国・ドイツ・フランス

グローバルネットワーク



- 開発・生産・営業・サポート
- 営業・サポート
- 開発・生産
- サポート

従業員数の推移（連結）※



※ 従業員数は、臨時従業員および再雇用従業員の年間平均雇用人員を含めた人数



**2027年2月期（第42期）
第1四半期（2026年3月～5月）
連結業績**

業績ハイライト



第1四半期（2026年3月～5月）連結

売上高

37,206 百万円

前年同期比 **+12.5%**

営業利益

10,230 百万円

営業利益率 **27.5%**

前年同期比 **+21.2%**

経常利益

10,938 百万円

経常利益率 **29.4%**

前年同期比 **+51.1%**

親会社株主に帰属する

四半期純利益

8,210 百万円

純利益率 **22.1%**

前年同期比 **+56.0%**

売上高が過去最高を更新

- 半導体関連装置の売上高 302億円で過去最高
- すべての品目で前年同期比増収

高い利益率を確保

- 売上増加による利益拡大および円安に伴う為替差益により増益
- 営業利益率27.5%、経常利益率29.4%と高い利益率を確保

受注高も過去最高を更新

- 半導体関連装置の受注高 420億円で前年同期比**1.9倍**
- 受注残高は**622億円**へ積み上がり大幅増加

連結業績

- 生成AIの普及・拡大などにより半導体設備投資が増加する中、好調な事業環境が継続
- 売上高は過去最高を更新し増収増益
- FPD関連装置や分析装置を含む全部門がそろって増収
- 売上増加や為替影響などにより、営業利益、経常利益、および四半期純利益は大幅な増益

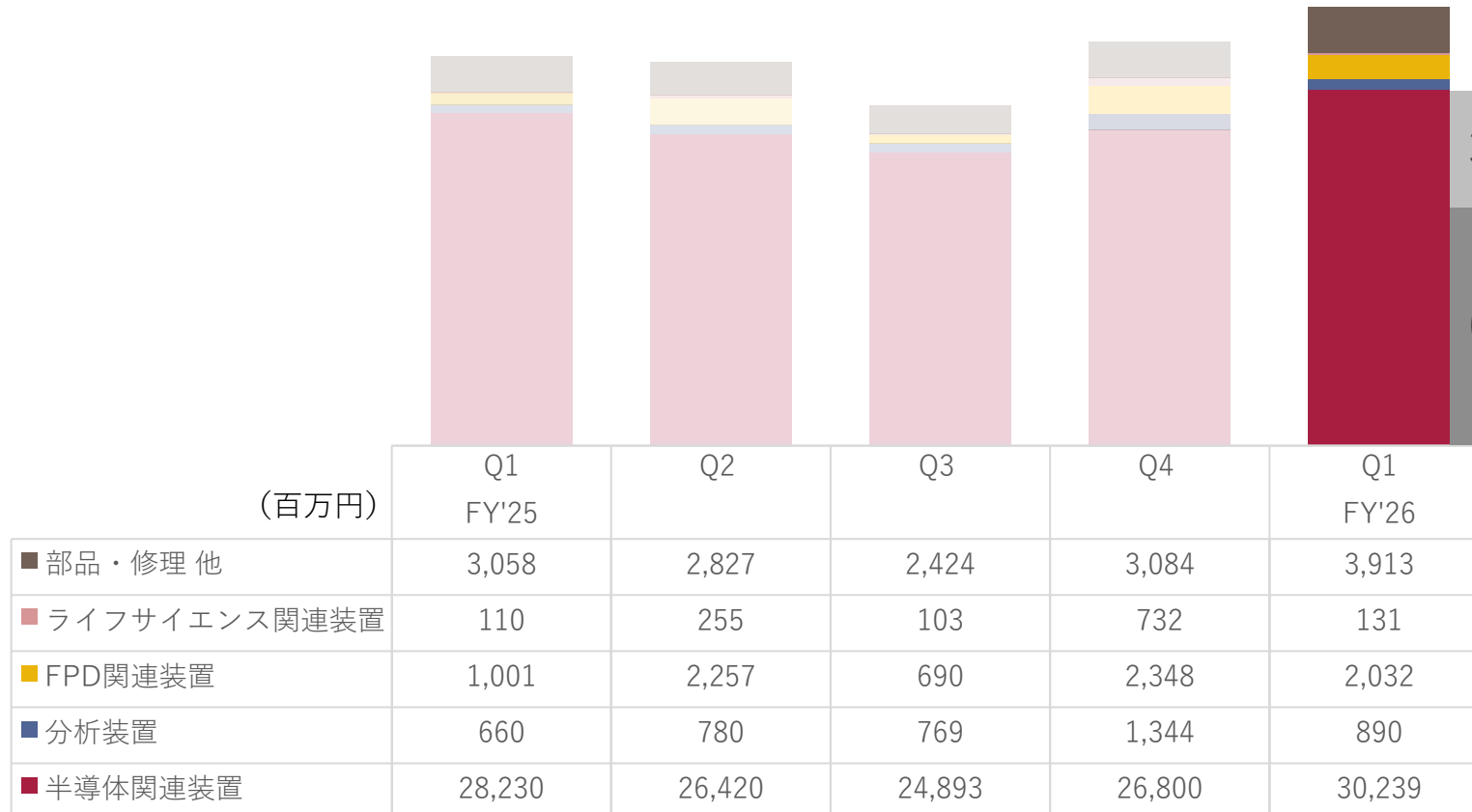
(百万円)


	FY'26 Q1	FY'25 Q1	前年同期比
売上高	37,206	33,061	112.5%
半導体関連装置	30,239	28,230	107.1%
分析装置	890	660	134.9%
F P D 関連装置	2,032	1,001	202.9%
ライフサイエンス関連装置	131	110	118.8%
部品・修理 他	3,913	3,058	127.9%
営業利益	10,230	8,441	121.2%
経常利益	10,938	7,241	151.1%
親会社株主に帰属する四半期純利益	8,210	5,263	156.0%
期中平均レート (円/USD)	156	152	—

四半期売上高の推移




- 四半期売上高が過去最高を更新
- 台湾、米国など、売上増に伴う保守部品やサービス関連売上が膨らみ「部品・修理 他」が増加
- 半導体関連装置は台湾ファウンドリ向けの増加などによりエンドユーザー向け比率が上昇






N2パージウエハストックカ




ウエハソータ

エンドユーザー

装置メーカー



EFEM

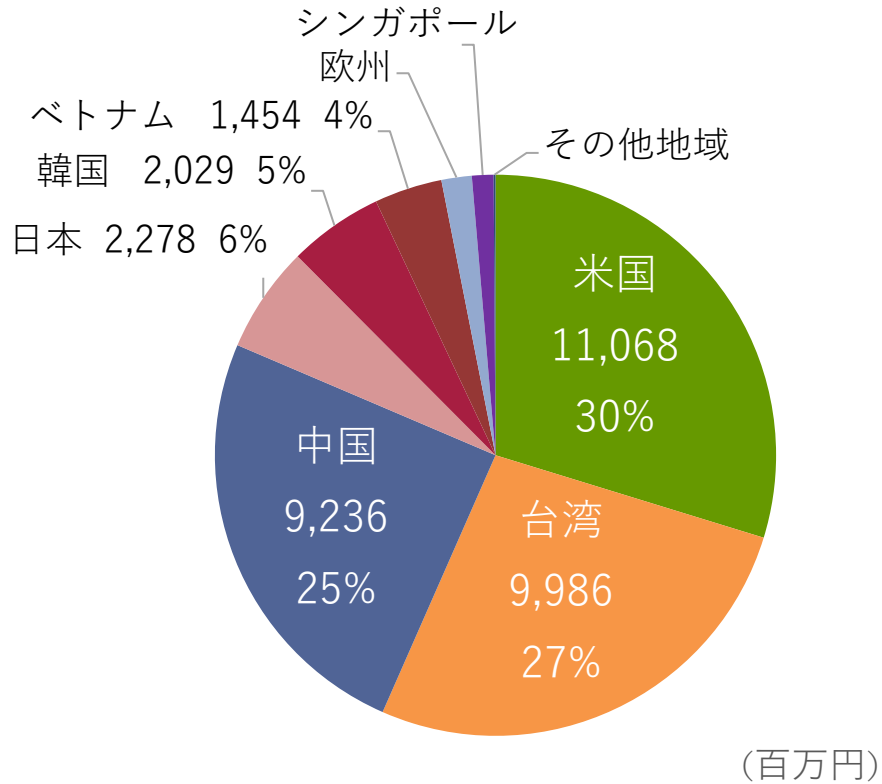


真空プラットフォーム

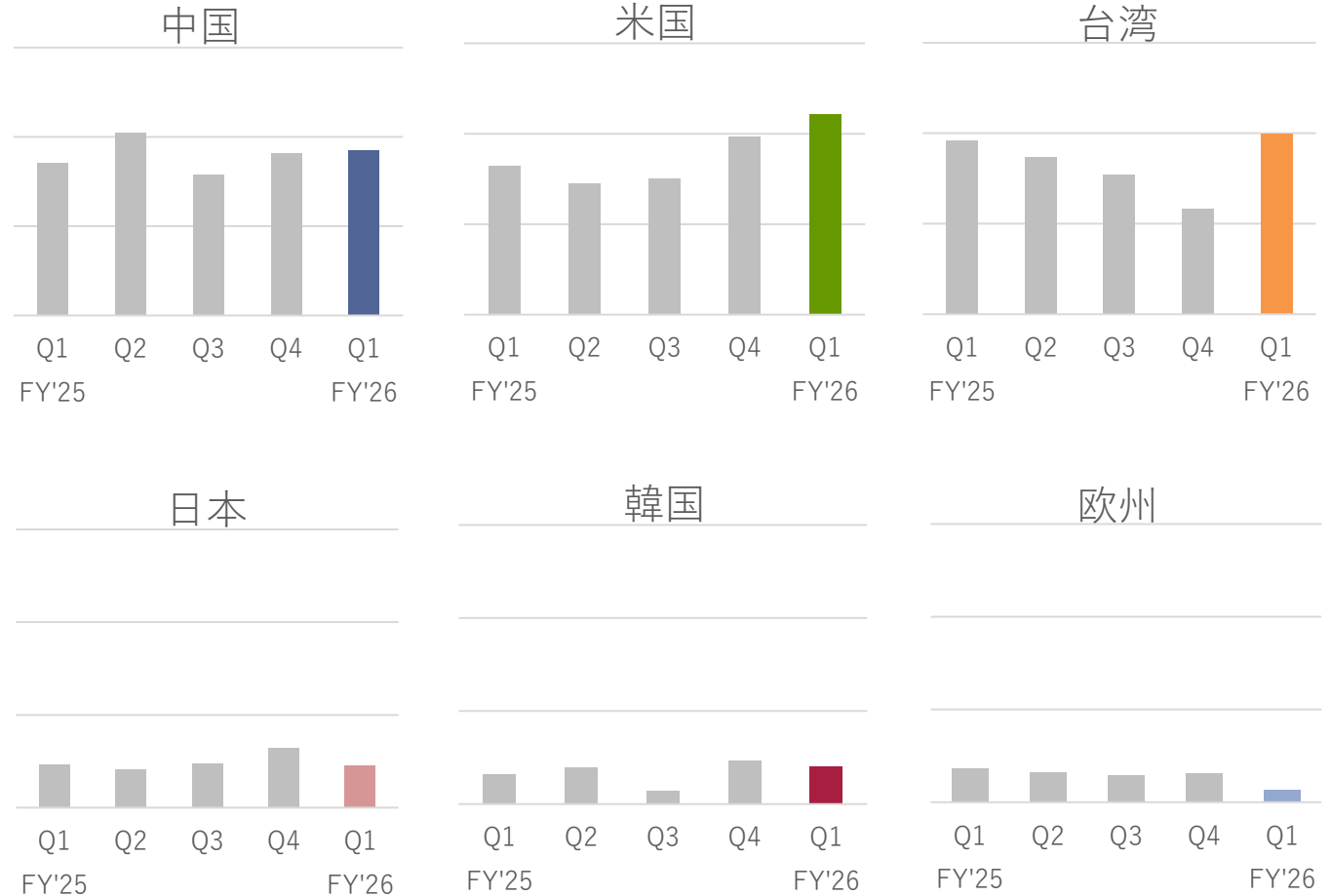
地域別売上高



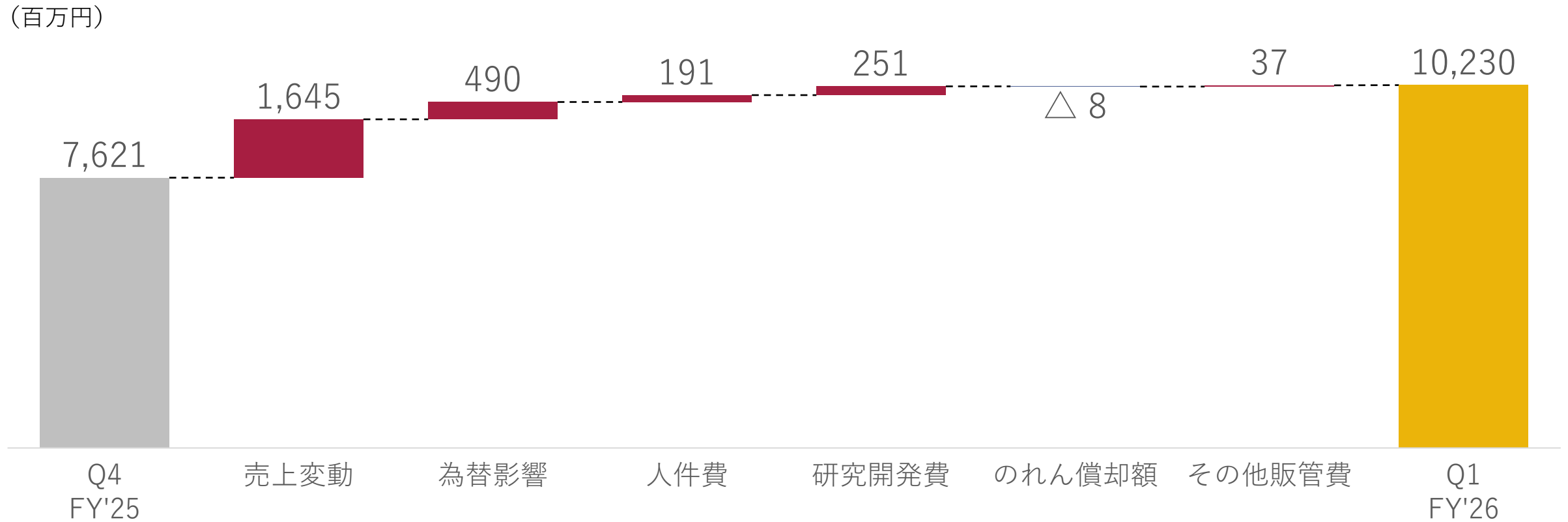
- 四半期売上高は米国および台湾で過去最高を更新。主要顧客向け売上が増加
- 中国向け売上も増加基調



※ 「地域別売上高」は顧客企業の本社所在地別に集計



■ 半導体関連装置を中心とした増収および円安効果により四半期ベースで過去最高益を更新



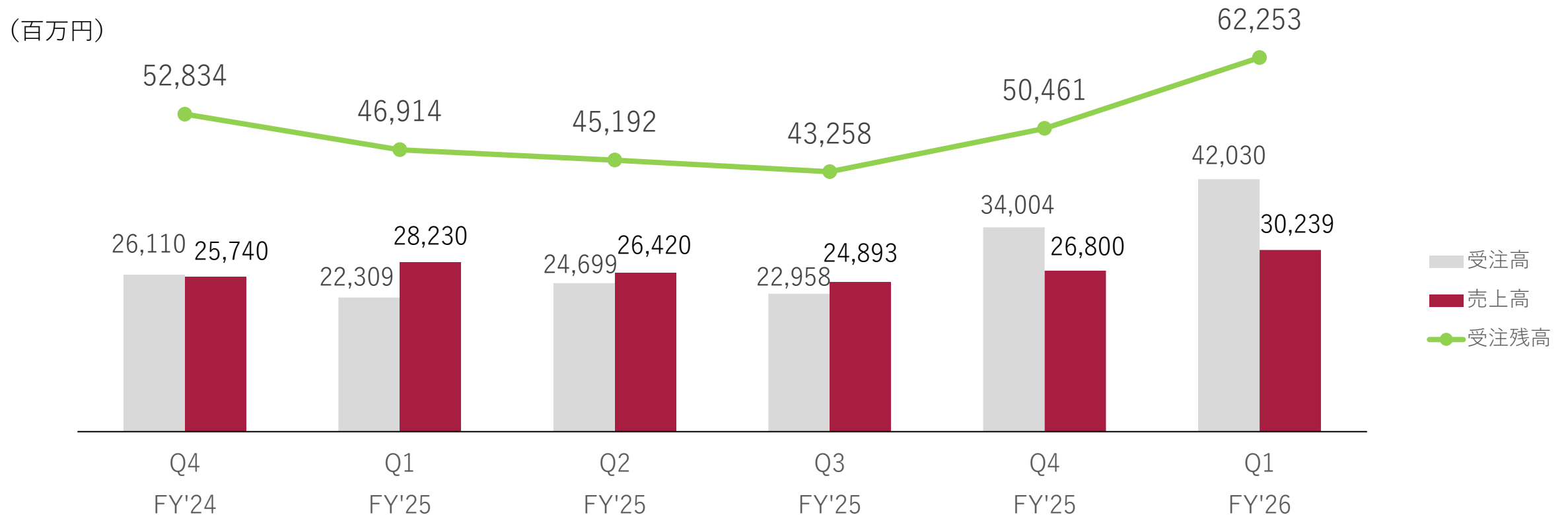
※ 連結営業利益に対するNanoverse社の影響額(百万円)： 人件費470、研究開発費31、のれん償却額738、その他販管費319

受注高・売上高・受注残高の推移



半導体関連装置

- 受注高は前四半期比80億円増の420億円と大幅伸長、2四半期連続で過去最高を更新
- 台湾の受注は前四半期の反動減、中国・米国が大幅増加



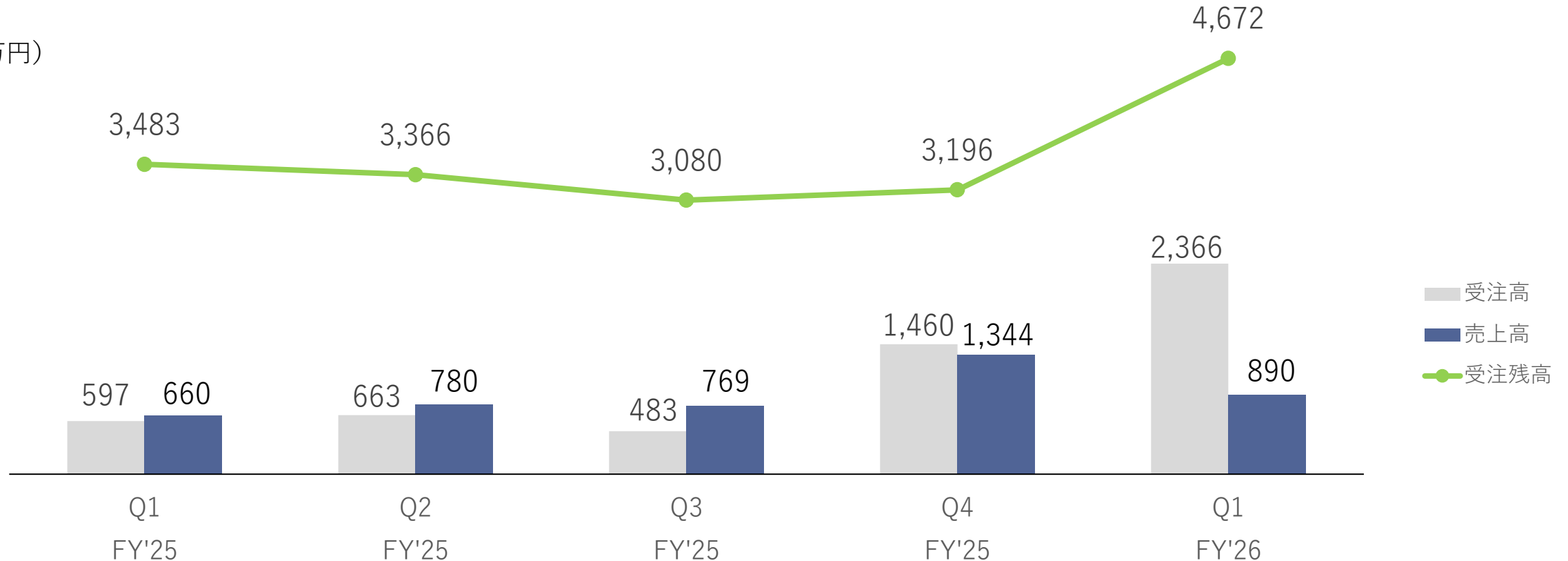
受注高・売上高・受注残高の推移



分析装置

- 受注高は前四半期比9億円増の23億円、受注残高も46億円に拡大
- 中国、欧州向けの受注が増加

(百万円)



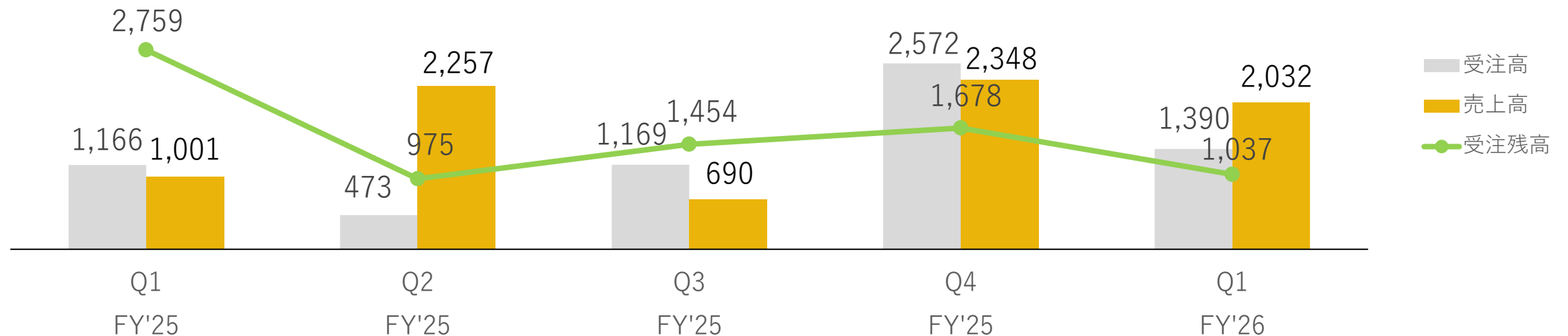
受注高・売上高・受注残高の推移



FPD関連装置

- ベトナム向けFPDモジュール工程用自動化装置を中心に、当四半期売上高は20億円を維持
- 客先の設備投資案件に対する提案活動を継続

(百万円)

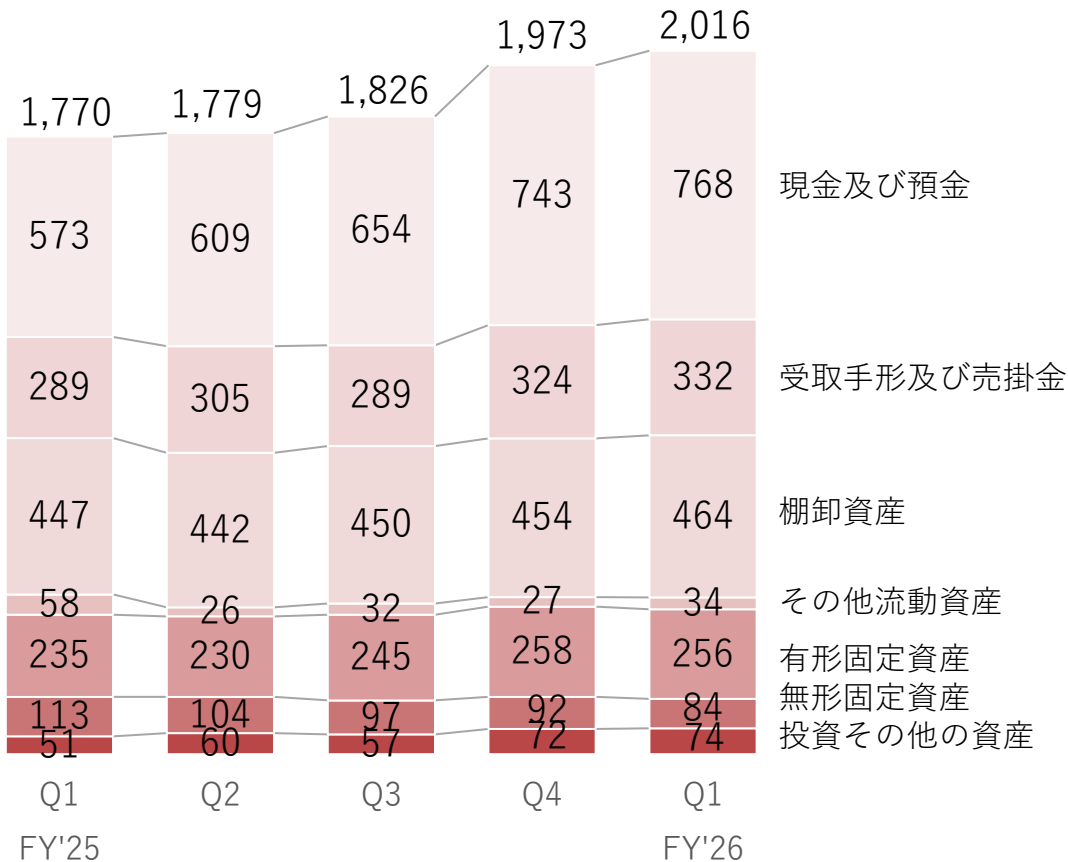


連結貸借対照表

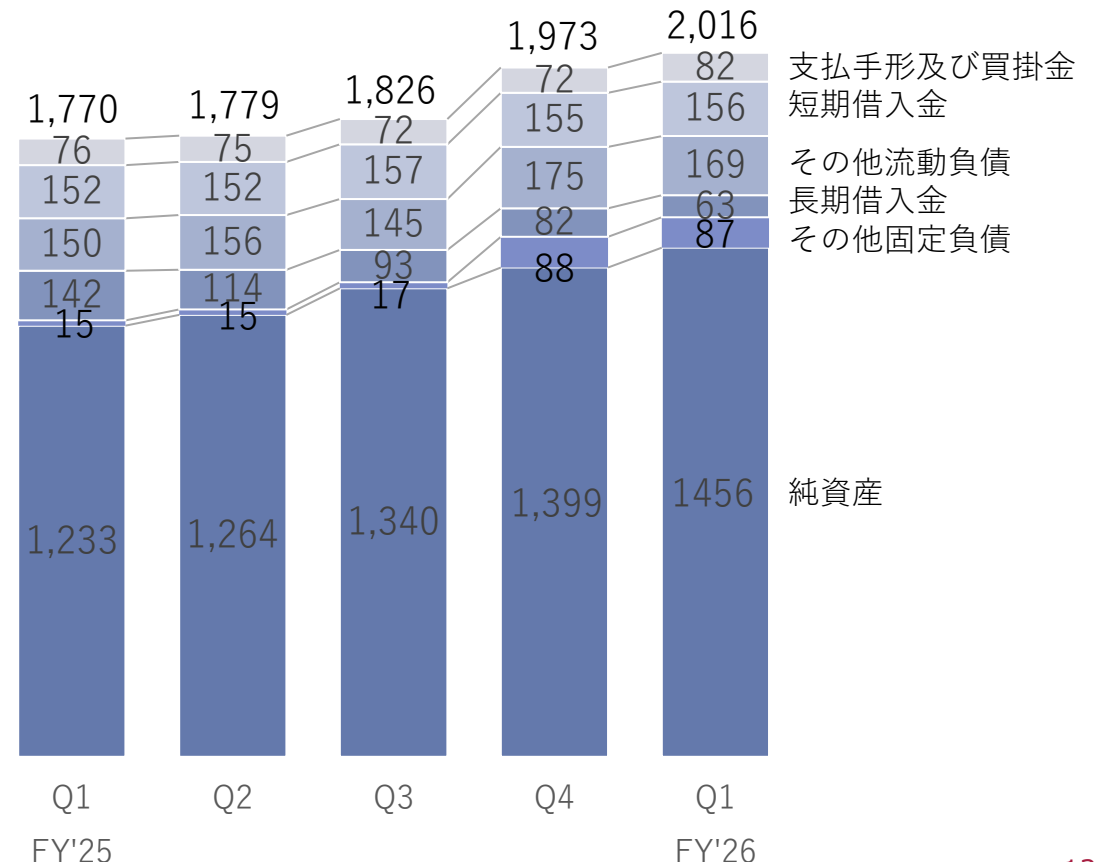


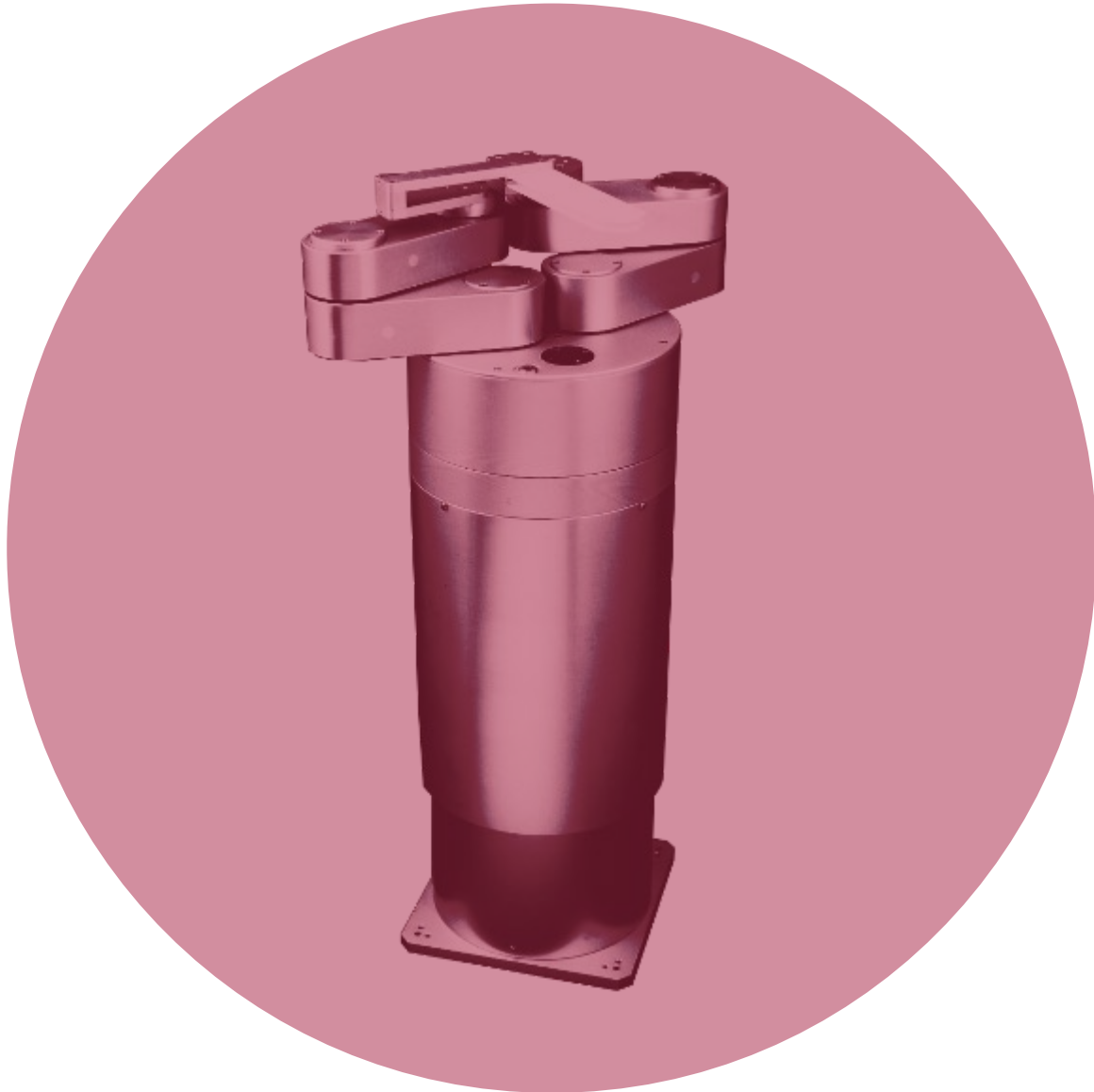
- 売上増加に伴い現金及び預金が増加、有利子負債を圧縮しつつ新工場等の設備投資資金を確保
- 受注増加に対応するための原材料などの増加により棚卸資産が増加

資産
(億円)



負債・純資産
(億円)





2027年2月期（第42期） 今後の見通し

2027年2月期 計画の進捗状況



- 売上高は、Q2予想に対する進捗率が若干弱含みながらもほぼ折り返し水準の47.9%を確保
- 2四半期連続の半導体関連装置大幅受注増により、Q2以降も力強い売上増加を見込む
- 保守、サービス需要の拡大により部品・修理他が好調な一方、FPD関連装置およびライフサイエンス関連装置の受注増加に向けた取り組みを継続中
- 利益はいずれも上期進捗率が50%超と予想を上回る好スタート

(百万円)

	FY'26 Q1 実績	FY'26 Q2 予想	Q2予想 進捗率	FY'26 通期予想	通期予想 進捗率
売上高	37,206	77,634	47.9%	159,021	23.4%
半導体関連装置	30,239	66,126	45.7%	132,480	22.8%
分析装置	890	1,613	55.2%	4,225	21.1%
FPD関連装置	2,032	4,258	47.7%	10,090	20.1%
ライフサイエンス関連装置	131	340	38.5%	1,588	8.3%
部品・修理 他	3,913	5,294	73.9%	10,636	36.8%
営業利益	10,230	19,088	53.6%	38,112	26.8%
経常利益	10,938	19,168	57.1%	38,241	28.6%
親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益	8,210	13,809	59.5%	27,809	29.5%

事業環境

- 生成AIの普及、活用拡大などにより、AIサーバー向けHBMを中心としたメモリ投資が増加、半導体需要が想定以上に拡大
- 半導体デバイスメーカーの新規大型設備投資計画の発表
- 先端半導体やアドバンスドパッケージ向け搬送装置の受注増加傾向が続く見通し

リスク

- メモリ価格の高騰、一部電子部品での供給逼迫や長納期化
- 中東情勢を背景とした原油価格変動による樹脂などの石油関連製品・梱包材等の価格上昇や供給不安定化など、調達面のリスクが顕在化

対応

- ベトナムや中国など子会社における増員、製品供給体制の増強
- 部材の先行手配、在庫確保や代替部品・代替調達先の確保など、納期影響の緩和をはかる



トピックス

ローゼイアス 新社屋建設



■ 新規開発を加速するための新社屋を建設予定

- 新製品開発、新規検査需要に対応するためのエンジニア用オフィススペースを拡大
- 顧客からのサンプルウエハ分析など、顧客ニーズに迅速にこたえるためラボ用クリーンルームを拡大
- 最先端半導体向け新規材料の分析手法について研究開発を行う



完成イメージ図（外観）

所在地	東京都日野市（現本社よりほど近く）
土地面積	3,406.89㎡（2025年11月 取得済）
建物延べ面積	4,497.25㎡ （3階建て 事務所・クリーンルーム）
工事予定期間	2026年9月1日～2027年12月31日
完成引渡予定時期	2027年12月末
投資総額（建物）	20億円（予定）

本社 研究開発棟の建設計画

RORZE

- 本社敷地内に、**研究開発棟の建設**計画を発表
- 既存の2倍のエンジニア用オフィススペースと共に、**クラス1**のエリアを含む装置開発・テスト用**クリーンルーム**、**電波暗室**、**精密測定室**などを含む
- 2027年7月の工事着工、**2029年秋の完成**を予定



敷地内外観（左から立体駐車場 / 新社屋 / 既存社屋）



内観（新社屋）

< 新社屋(新築) >

S造8階建て / 延べ面積約18,000㎡

1F：エントランスホール / 展示ホール

2F：開発クリーンルーム /
コラボレーションラウンジ
(商談・客先トレーニングスペース)

3F：イノベーションデッキ(共創スペース)

4～6F：執務室

7F：コワーキングスペース / 会議室 /
多目的スペース / 応接室 /
空中歩廊 / 来客・従業員エントランス

8F：倉庫 / 太陽光パネルなど



參考資料



ユニット



大気用搬送ロボット



アライナ



ロードポート

システム



EFEM



真空プラットフォーム

システム



ウエハソータ



N2ページウエハストック

装置メーカー

プロセス装置
検査装置

エンドユーザー

デバイスメーカー
ウエハメーカー

アドバンスドパッケージ

より小さいフットプリントで高いデバイス密度と機能拡張を実現できるようにチップレットを接続する方法

■PCB(プリント基板)上でのパッケージング

前工程 1 ウェハで1種類のチップ

これまでのローツェ搬送装置の市場

後工程 1 パッケージで1種類のチップ

PCB基板上にマウンターでパッケージング
(各半導体間はPCB基板を通じて通信)

■シリコンウェハ上でのパッケージング

中工程 後工程のパッケージングをする代わりに、
・ウェハを薄くしてシリコンを貫通する通信用の縦穴形成 (TSV: Through Silicon Via)
・インターポーザ (※) 上で**複数のウェハを3Dに積層する**

ローツェの搬送装置が必要な新市場が拡大 (前工程 + 中工程)

● アドバンスドパッケージ用装置

- ・ Tape Frame Sorter
- ・ PLP EFEM など

※インターポーザ: 貫通電極によって表裏の回路の導通をとり中継する基板
(シリコンインターポーザ、ガラスインターポーザ、有機インターポーザ)

アドバンスドパッケージ用装置



PLP用EFEM



Tape Frame用ソーター





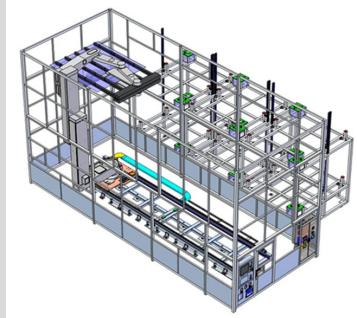
半導体業界
製造装置メーカー
エンドユーザー
デバイスメーカー
ウエハメーカー

半導体業界以外
研究機関
環境計測機器
化学薬品メーカー
など

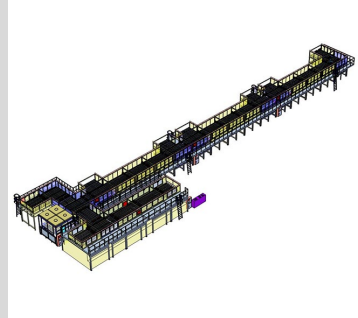
FPD関連装置



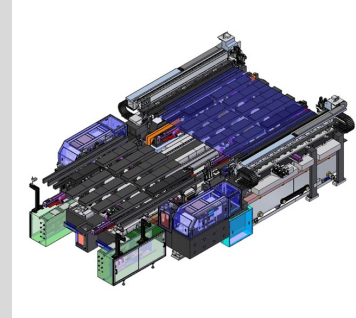
ローツェシステムズ
(韓国子会社)



INDEX超大型搬送システム



インライン搬送システム

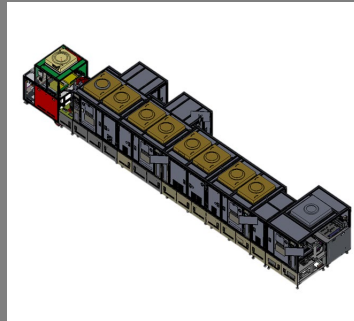


レーザーカッティング装置



前工程：

FPDメーカー
FPD用ガラスメーカー



ディスプレイモジュール機器



Packing 超大型Cell装置



後工程：

FPDメーカー

ライフサイエンス関連装置



インキュベータ
SCALE48



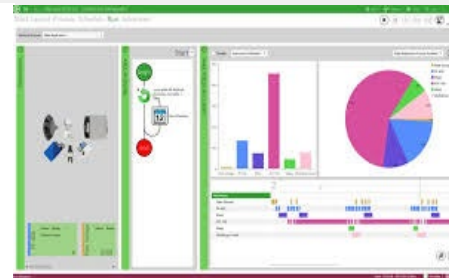
自動培地交換機能&細胞観察
機能付きCO2インキュベータ
CellKeeper® II 48Plus



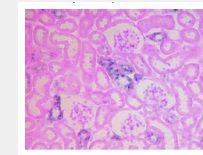
モバイルロボット



全自動培地交換システム
CellFarm(L)-360™



スケジューリングソフトウェア
Green Button Go™ ※
(※Biosero社製)



試験受託(細胞染色)



ジェノスタッフ株式会社



大学・製薬企業等
研究機関
再生医療関連企業

RORZE